

興大攜手台積電打造先進封裝專屬學程

[感謝本校秘書室媒體公關組提供資料](#)

中興大學與台積電連續兩年推動「台積電半導體先進封裝學程」，盤點全校跨學院科系半導體相關基礎與進階課程，開放全校所有系所同學申請，修畢 45 學分即可獲得學程認證。

興大研發長宋振銘表示，中興大學重視理工電資領域發展，且臨近中科，為產業科技人才培育最佳搖籃。為了深耕半導體工程師培育，興大與台積電合作推出「台積電半導體先進封裝學程」，涵蓋電機、材料、化工、機械、物理、化學等科系，整合 29 門學程科目供同學選修。

該學程包含三大學能領域，分別為半導體元件關鍵學能 8 門、先進封裝技術基礎學能 11 門、先進封裝與設計分析 10 門。對於有志投入半導體產業的學生，這個學程不僅提供第二專業，也能深入了解產業發展趨勢，取得學程修畢證明，對未來求職有所助益。其中特色課程「異質整合製造與技術」，今年暑假將邀請兩位專精 3D IC 技術的日本教授到校授課。

3 月 27 日興大與台積電共同舉辦學程說明會，吸引近 200 位學生到場聆聽。台積電半導體先進封裝學程是一個虛擬學程，由興大現有半導體相關理論基礎、進階至實務各科目，加上特色課程進行整合規劃。學生修習指定課程除了可獲得台積電學程認證之外，若到有開設台積電半導體學程的它校繼續學業，修過的課程同樣可獲得採計，因此建議同學們盡早參與並規劃選課方向。

參加台積電半導體學程的學生，享有業師講授專屬課程，有機會至中科台積電新人訓練中心參與新進工程師必修的半導體設備與元件等實習課程。

宋振銘表示，興大近期內將陸續與台積電合作開設另外四個學程，分別是元件/整合、製程/模組、設備工程及前瞻電路設計，提供更多元的半導體培訓學程供學生選擇。